



平成 25 年 7 月 30 日

各 位

会 社 名 株式会社テラプローブ
代 表 者 代表取締役社長 渡辺 雄一郎
(コード番号：6627)東証マザーズ
問合せ先 執行役員 CFO 神戸 一仁
(TEL 045-476-5711)

連結子会社の吸収合併(簡易合併・略式合併)に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、当社連結子会社である株式会社テラミクロスを吸収合併することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本合併は 100%子会社を対象とする簡易吸収合併のため、開示事項・内容を一部省略して開示しております。

記

1. 合併の目的

半導体テストとウエハレベルパッケージを包括的に提供するターンキーサービスの充実を図ることで、事業基盤の強化を図り、グループ経営の効率化を推進するためであります。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

- | | |
|-----------------|---|
| ① 合併決議取締役会 | : 平成 25 年 7 月 30 日 |
| ② 合併契約締結日 | : 平成 25 年 7 月 30 日 |
| ③ 合併承認株主総会 | : 本合併は、当社においては、会社法第 796 条第 3 項に規定する簡易合併であるため、合併契約承認株主総会を開催いたしません。 |
| ④ 合併予定日 (効力発生日) | : 平成 25 年 10 月 1 日 |

(2) 合併方式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、株式会社テラミクロスは解散いたします。

(3) 合併に係る割当ての内容

該当事項はありません。

(4) 消滅会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

該当事項はありません。

3. 合併当事会社の概要

(1) 名称	株式会社テラプローブ (存続会社)	株式会社テラミクロス (消滅会社)
(2) 所在地	神奈川県横浜市港北区新横浜 2-7-17	東京都青梅市今井 3-10-6
(3) 代表者の 役職・氏名	代表取締役社長 渡辺 雄一郎	代表取締役社長 渡辺 雄一郎
(4) 事業内容	半導体テスト及び関連業務の受託	半導体パッケージの開発、製造、販売
(5) 資本金	11,823 百万円	300 百万円
(6) 設立年月日	平成 17 年 8 月	平成 23 年 7 月
(7) 発行済株式数	9,282,500 株	2 株
(8) 決算期	3 月 31 日	3 月 31 日
(9) 大株主及び 持株比率	エルピーダメモリ株式会社 39.64% MSIP CLIENT SECURITIES 12.16% GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 8.29% 株式会社アドバンテスト 8.18% UBS AG HONG KONG 3.29%	株式会社テラプローブ 100%
(10) 直前事業年度の財政状態及び経営成績		
決算期	平成 25 年 3 月期(連結)	平成 25 年 3 月期
純資産	22,237 百万円	1,032 百万円
総資産	35,542 百万円	3,707 百万円
1 株当たり純資産	2,165.57 円	516 百万円
売上高	21,306 百万円	4,261 百万円
営業利益	△42 百万円	△960 百万円
経常利益	101 百万円	△981 百万円
当期純利益	500 百万円	△624 百万円
1 株当たり当期純利益	53.87 円	△312 百万円

4. 合併後の状況（予定）

本合併後の当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期に変更はありません。

5. 当社の業績に与える影響

本合併は、当社 100%出資の連結子会社との合併であるため、連結業績への影響はありません。

以 上